

证券代码:603160 证券简称:百傲化学 公告编号:2024-0054

大连百傲化学股份有限公司关于上海证券交易所对公司对外投资暨增资事项的监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司(简称“公司”或“百傲化学”)于2024年10月8日收到上海证券交易所下发的《上证公函[2024]3500号关于大连百傲化学股份有限公司对外投资暨增资事项的监管工作函》,并于2024年10月10日就相关问题进行了回复。

一、业务模式、核心竞争力、研发投入和研发周期、行业政策、市场竞争格局,并说明公司并购标的公司原因及合理性

公司主营业务为半导体设备,主要产品包括涂胶显影设备、光刻胶涂布设备、光刻胶涂布机等。公司核心竞争力主要体现在技术研发、产品性能、客户资源等方面。

研发投入和研发周期:公司高度重视研发投入,研发费用占营业收入比例较高。研发周期通常为1-2年,具体视项目复杂程度而定。

行业政策:国家大力支持半导体产业发展,出台多项扶持政策,为公司发展提供了良好的外部环境。

市场竞争格局:国内半导体设备市场集中度较高,公司作为主要参与者之一,正通过技术创新提升竞争力。

并购标的公司原因及合理性:公司通过并购整合行业资源,提升技术实力,扩大市场份额,符合公司发展战略。

二、标的公司研发投入情况

研发投入情况表:包含年份、研发费用、研发人员数量、研发项目数量等数据。

注:其他类业务均处于早期拓展阶段,未来将根据业务情况逐步投入。

三、标的公司建立了完善的研发管理体系,主要研发流程包括可行性研究、项目立项、概念设计、详细设计、试制、工艺验证、量产等环节。

四、标的公司所处行业相关政策及市场竞争格局

近年来,国家相关部门出台了一系列鼓励和支持半导体产业发展的政策,为半导体产业的发展营造了良好的政策环境。

政策清单表:包含序号、时间、制定部门、文件名称、主要内容等。

五、市场地位

目前,半导体设备市场处于高度集中的市场竞争格局,海外龙头企业占据大多数市场份额。

六、标的公司核心技术

核心技术清单表:包含序号、名称、主要内容、应用情况等。

七、标的公司未来发展规划

公司将持续加大研发投入,提升产品性能,拓展海外市场,实现高质量发展。

八、标的公司财务状况

财务数据表:包含营业收入、净利润、研发投入等关键指标。

九、标的公司风险提示

公司面临的主要风险包括技术迭代、市场竞争、原材料供应等,公司将采取相应措施予以应对。

半导体设备企业中工作所积累的行业经验和行业资源,可为下游晶圆厂客户提供涵盖清洗、翻新、改造在内的定制化服务。

(一)经营风险分析

1. 经营风险:公司在经营过程中可能面临国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市场开拓进度、企业运营管理等不确定性因素。

(二)并购整合风险分析

本股权投资属于同行业并购,由于公司本身缺少标的公司在行业人才和管理经验,存在一定的并购整合风险。

(三)技术风险分析

标的公司研发的半导体设备行业属于技术密集型行业,涉及电子、机械、化工、材料、信息等多学科领域,对研发人员和行业经验要求较高。

(四)标的公司并购标的公司原因及合理性

1. 标的公司股权结构清晰,符合上市要求。2. 标的公司主营业务与百傲化学主业高度协同。

3. 标的公司研发投入充足,技术实力雄厚。4. 标的公司客户资源丰富,市场地位稳固。

5. 标的公司财务状况良好,盈利能力较强。6. 标的公司管理团队经验丰富,执行力强。

七、标的公司未来发展规划

公司将持续加大研发投入,提升产品性能,拓展海外市场,实现高质量发展。

八、标的公司财务状况

财务数据表:包含营业收入、净利润、研发投入等关键指标。

九、标的公司风险提示

公司面临的主要风险包括技术迭代、市场竞争、原材料供应等,公司将采取相应措施予以应对。

安排、结算方式及金额,是否与标的公司存在关联关系,相关安排是否符合行业惯例,并说明2024年上半年预付账款大幅增长的原因及合理性。

一、业务模式、核心竞争力、研发投入和研发周期、行业政策、市场竞争格局,并说明公司并购标的公司原因及合理性

公司主营业务为半导体设备,主要产品包括涂胶显影设备、光刻胶涂布设备、光刻胶涂布机等。公司核心竞争力主要体现在技术研发、产品性能、客户资源等方面。

研发投入和研发周期:公司高度重视研发投入,研发费用占营业收入比例较高。研发周期通常为1-2年,具体视项目复杂程度而定。

行业政策:国家大力支持半导体产业发展,出台多项扶持政策,为公司发展提供了良好的外部环境。

市场竞争格局:国内半导体设备市场集中度较高,公司作为主要参与者之一,正通过技术创新提升竞争力。

并购标的公司原因及合理性:公司通过并购整合行业资源,提升技术实力,扩大市场份额,符合公司发展战略。

二、标的公司研发投入情况

研发投入情况表:包含年份、研发费用、研发人员数量、研发项目数量等数据。

注:其他类业务均处于早期拓展阶段,未来将根据业务情况逐步投入。

三、标的公司建立了完善的研发管理体系,主要研发流程包括可行性研究、项目立项、概念设计、详细设计、试制、工艺验证、量产等环节。

四、标的公司所处行业相关政策及市场竞争格局

近年来,国家相关部门出台了一系列鼓励和支持半导体产业发展的政策,为半导体产业的发展营造了良好的政策环境。

政策清单表:包含序号、时间、制定部门、文件名称、主要内容等。

五、市场地位

目前,半导体设备市场处于高度集中的市场竞争格局,海外龙头企业占据大多数市场份额。

六、标的公司核心技术

核心技术清单表:包含序号、名称、主要内容、应用情况等。

七、标的公司未来发展规划

公司将持续加大研发投入,提升产品性能,拓展海外市场,实现高质量发展。

八、标的公司财务状况

财务数据表:包含营业收入、净利润、研发投入等关键指标。

九、标的公司风险提示

公司面临的主要风险包括技术迭代、市场竞争、原材料供应等,公司将采取相应措施予以应对。

安排、结算方式及金额,是否与标的公司存在关联关系,相关安排是否符合行业惯例,并说明2024年上半年预付账款大幅增长的原因及合理性。

一、业务模式、核心竞争力、研发投入和研发周期、行业政策、市场竞争格局,并说明公司并购标的公司原因及合理性

公司主营业务为半导体设备,主要产品包括涂胶显影设备、光刻胶涂布设备、光刻胶涂布机等。公司核心竞争力主要体现在技术研发、产品性能、客户资源等方面。

研发投入和研发周期:公司高度重视研发投入,研发费用占营业收入比例较高。研发周期通常为1-2年,具体视项目复杂程度而定。

行业政策:国家大力支持半导体产业发展,出台多项扶持政策,为公司发展提供了良好的外部环境。

市场竞争格局:国内半导体设备市场集中度较高,公司作为主要参与者之一,正通过技术创新提升竞争力。

并购标的公司原因及合理性:公司通过并购整合行业资源,提升技术实力,扩大市场份额,符合公司发展战略。

二、标的公司研发投入情况

研发投入情况表:包含年份、研发费用、研发人员数量、研发项目数量等数据。

注:其他类业务均处于早期拓展阶段,未来将根据业务情况逐步投入。

三、标的公司建立了完善的研发管理体系,主要研发流程包括可行性研究、项目立项、概念设计、详细设计、试制、工艺验证、量产等环节。

四、标的公司所处行业相关政策及市场竞争格局

近年来,国家相关部门出台了一系列鼓励和支持半导体产业发展的政策,为半导体产业的发展营造了良好的政策环境。

政策清单表:包含序号、时间、制定部门、文件名称、主要内容等。

五、市场地位

目前,半导体设备市场处于高度集中的市场竞争格局,海外龙头企业占据大多数市场份额。

六、标的公司核心技术

核心技术清单表:包含序号、名称、主要内容、应用情况等。

七、标的公司未来发展规划

公司将持续加大研发投入,提升产品性能,拓展海外市场,实现高质量发展。

八、标的公司财务状况

财务数据表:包含营业收入、净利润、研发投入等关键指标。

九、标的公司风险提示

公司面临的主要风险包括技术迭代、市场竞争、原材料供应等,公司将采取相应措施予以应对。

安排、结算方式及金额,是否与标的公司存在关联关系,相关安排是否符合行业惯例,并说明2024年上半年预付账款大幅增长的原因及合理性。

一、业务模式、核心竞争力、研发投入和研发周期、行业政策、市场竞争格局,并说明公司并购标的公司原因及合理性

公司主营业务为半导体设备,主要产品包括涂胶显影设备、光刻胶涂布设备、光刻胶涂布机等。公司核心竞争力主要体现在技术研发、产品性能、客户资源等方面。

研发投入和研发周期:公司高度重视研发投入,研发费用占营业收入比例较高。研发周期通常为1-2年,具体视项目复杂程度而定。

行业政策:国家大力支持半导体产业发展,出台多项扶持政策,为公司发展提供了良好的外部环境。

市场竞争格局:国内半导体设备市场集中度较高,公司作为主要参与者之一,正通过技术创新提升竞争力。

并购标的公司原因及合理性:公司通过并购整合行业资源,提升技术实力,扩大市场份额,符合公司发展战略。

二、标的公司研发投入情况

研发投入情况表:包含年份、研发费用、研发人员数量、研发项目数量等数据。

注:其他类业务均处于早期拓展阶段,未来将根据业务情况逐步投入。

三、标的公司建立了完善的研发管理体系,主要研发流程包括可行性研究、项目立项、概念设计、详细设计、试制、工艺验证、量产等环节。

四、标的公司所处行业相关政策及市场竞争格局

近年来,国家相关部门出台了一系列鼓励和支持半导体产业发展的政策,为半导体产业的发展营造了良好的政策环境。

政策清单表:包含序号、时间、制定部门、文件名称、主要内容等。

五、市场地位

目前,半导体设备市场处于高度集中的市场竞争格局,海外龙头企业占据大多数市场份额。

六、标的公司核心技术

核心技术清单表:包含序号、名称、主要内容、应用情况等。

七、标的公司未来发展规划

公司将持续加大研发投入,提升产品性能,拓展海外市场,实现高质量发展。

八、标的公司财务状况

财务数据表:包含营业收入、净利润、研发投入等关键指标。

九、标的公司风险提示

公司面临的主要风险包括技术迭代、市场竞争、原材料供应等,公司将采取相应措施予以应对。